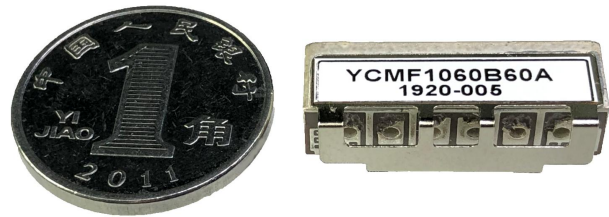


**特点:**

- -3dB 带宽:  $\geq 60\text{MHz}$
- 带外抑制: @1360MHz $\geq 70\text{dB}$
- 带内驻波比: 典型值 1.5:1
- SMT 封装
- 封装尺寸: 20.5×8.8 (max) ×5.4mm<sup>3</sup>
- 工作温度: -55~+85℃
- 产品执行标准为 SJ20764-1999

**图片:**

**性能参数: (T<sub>A</sub>=25℃, 50Ω系统)**

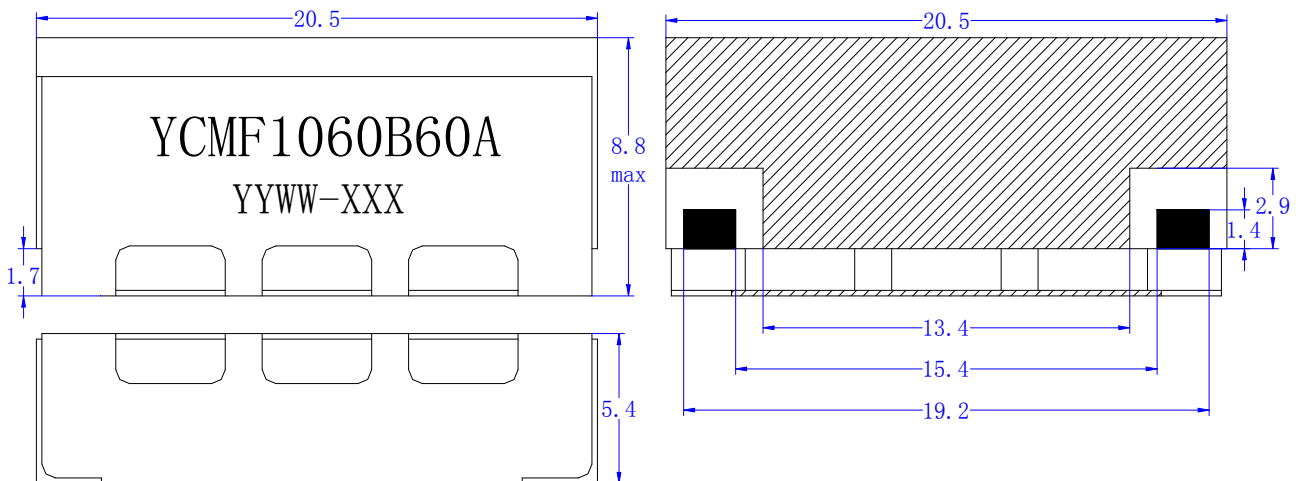
| 参数名称    | 符号                 | 测试条件  | 参数值     |       |       | 单位  | 备注 |
|---------|--------------------|---|---------|-------|-------|-----|----|
|         |                    |   | MIN     | TYP   | MAX   |     |    |
| 中心频率    | f <sub>0</sub>     |   | 1060±10 |       |       | MHz |    |
| -3dB 带宽 | BW <sub>-3dB</sub> |   | 60      |       |       | MHz |    |
| 插入损耗    | IL                 | P <sub>IN</sub> =0dBm f <sub>TEST</sub> =1060MHz      |         | 2.0   | 2.3   | dB  |    |
| 输入带内驻波比 | VSWR <sub>i</sub>  | P <sub>IN</sub> =0dBm f <sub>TEST</sub> =1040~1080MHz |         | 1.5:1 | 2.0:1 |     |    |
| 输出带内驻波比 | VSWR <sub>o</sub>  |   |         | 1.5:1 | 2.0:1 |     |    |
| 阻带抑制    | SR <sub>1</sub>    | P <sub>IN</sub> =0dBm f <sub>TEST</sub> =1~830MHz     | 50      |       |       | dB  |    |
|         | SR <sub>2</sub>    | P <sub>IN</sub> =0dBm f <sub>TEST</sub> =1230~1630MHz | 50      |       |       | dB  |    |
|         | SR <sub>3</sub>    | P <sub>IN</sub> =0dBm f <sub>TEST</sub> =1360MHz      | 70      |       |       | dB  |    |
| 质量      | m                  |   |         |       | 10.0  | g   |    |

**极限参数表:**

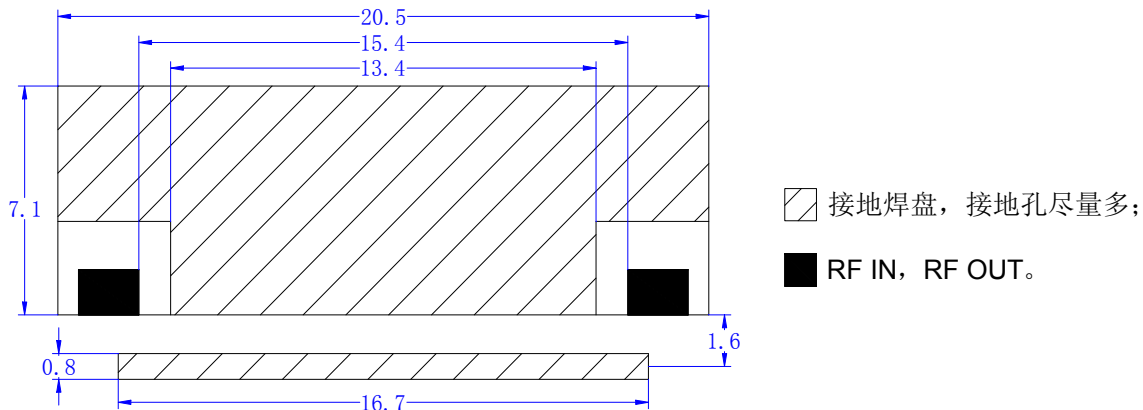
| 参数名称   | 极限值      | 单位  |
|--------|----------|-----|
| 贮存温度   | -55~+100 | ℃   |
| 输入射频功率 | 30.0     | dBm |

**封装外形及引脚标识图:**

单位: mm 公差: ±0.3mm



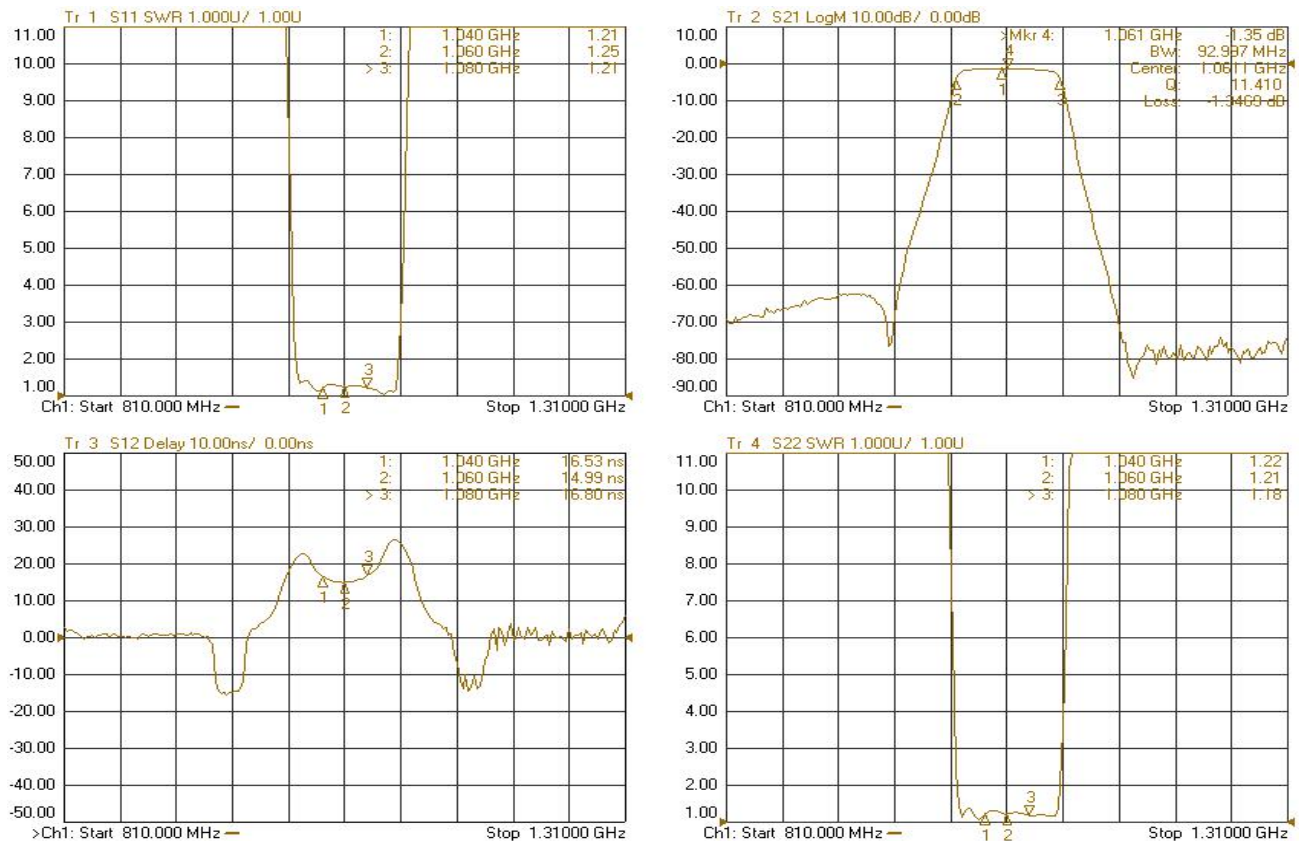
表面处理: 陶瓷介质镀银, 屏蔽罩镀镍。

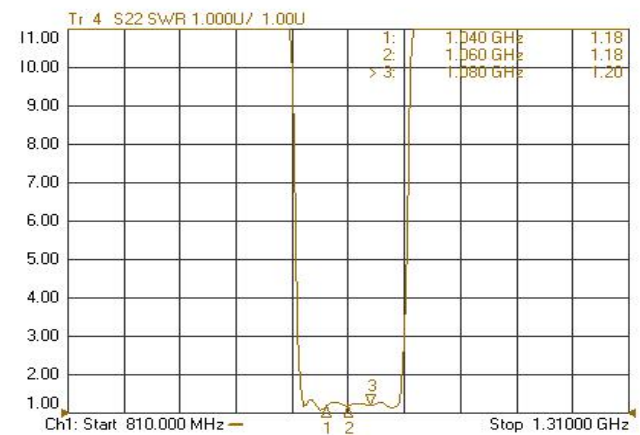
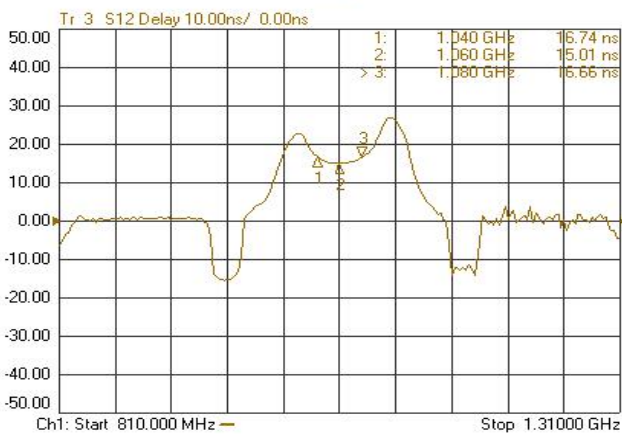
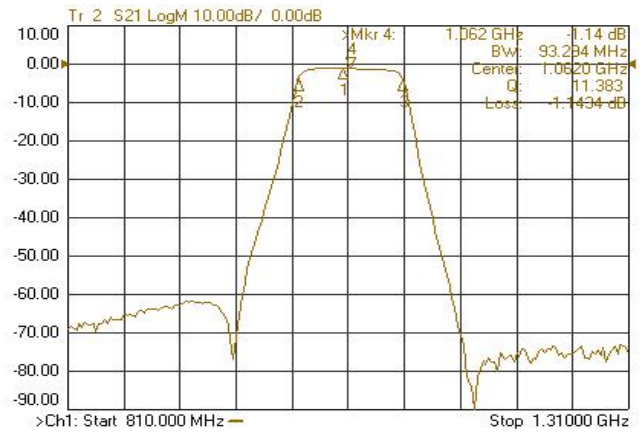
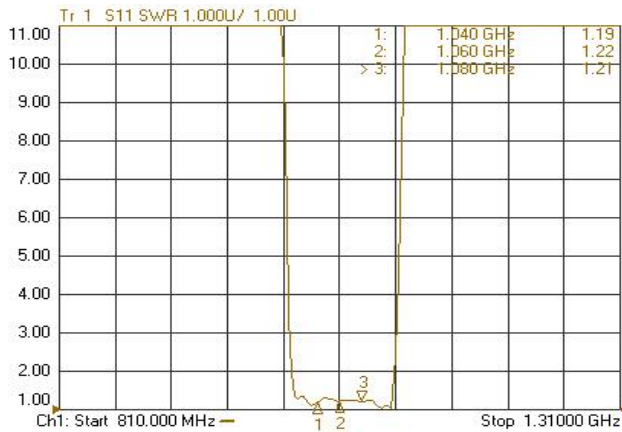
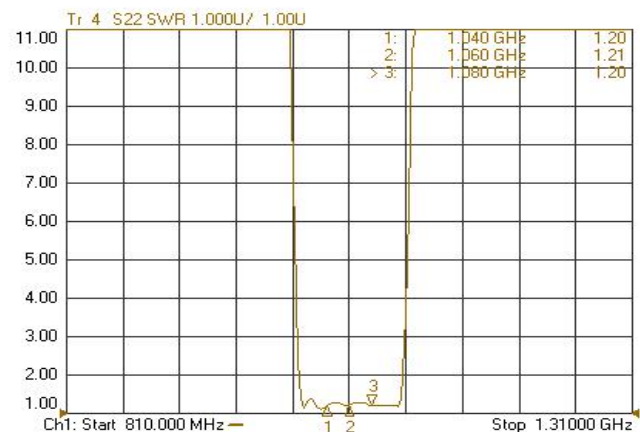
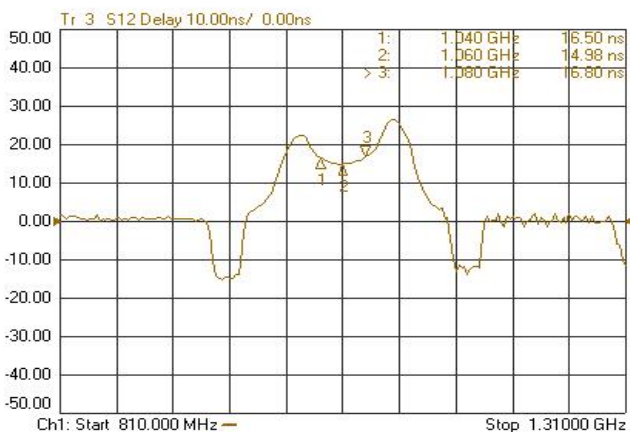
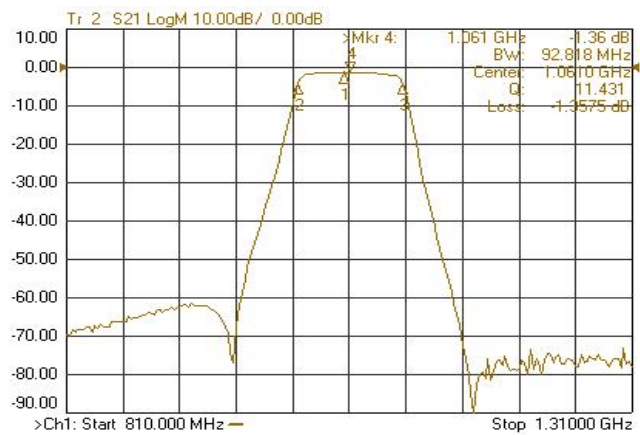
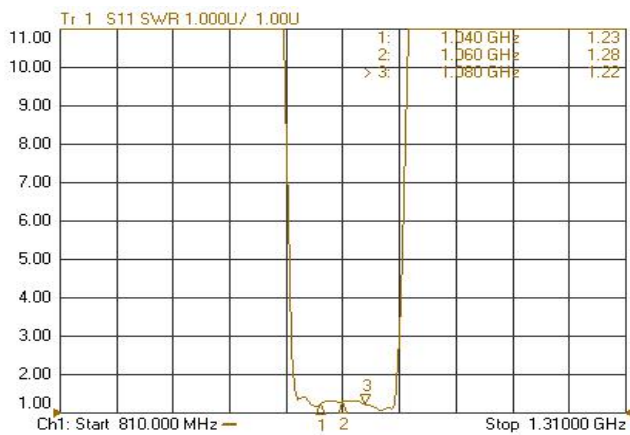
**推荐焊盘图:**

**字符标志:**

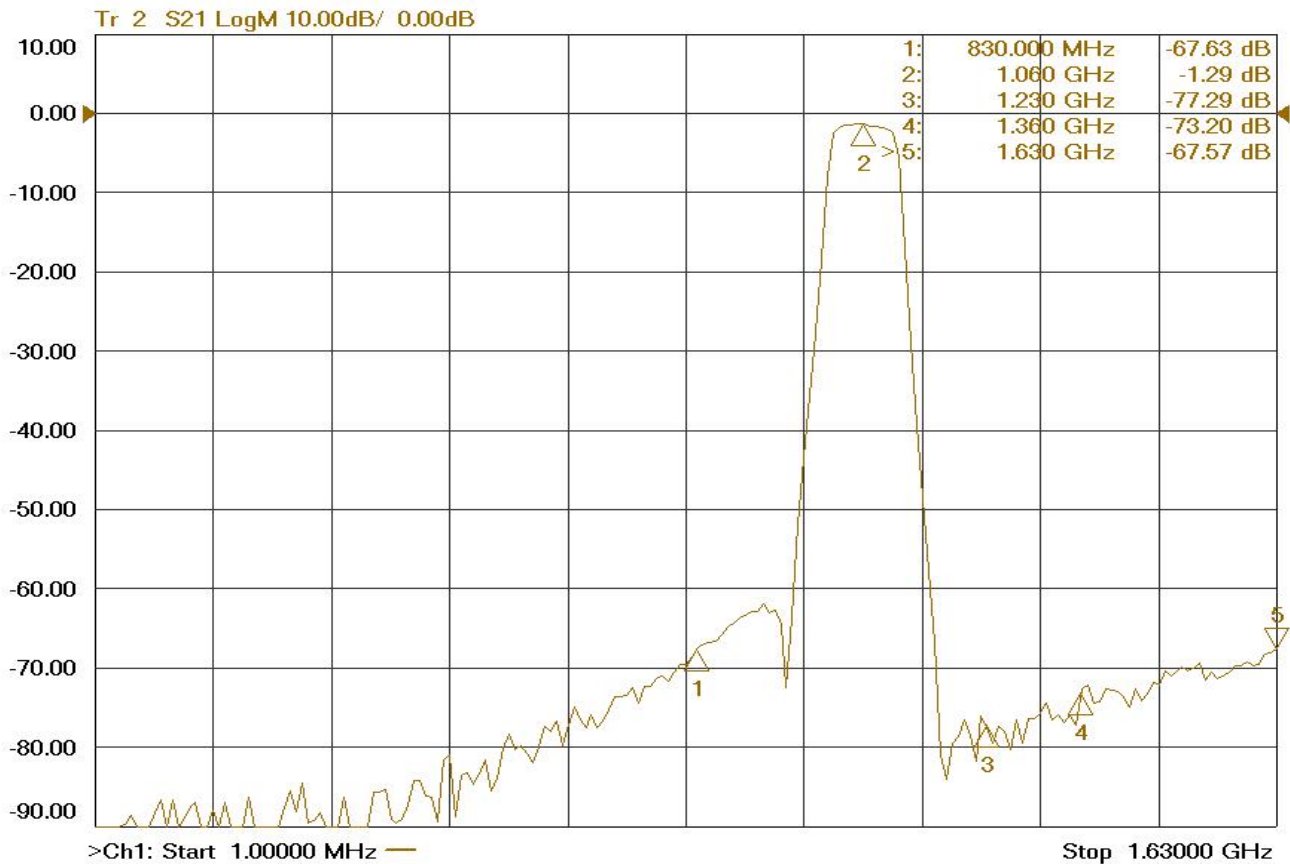
|              |      |
|--------------|------|
| YCMF1060B60A | 产品型号 |
| YYWW         | 批次号  |
| XXX          | 序列号  |

**引脚定义:**

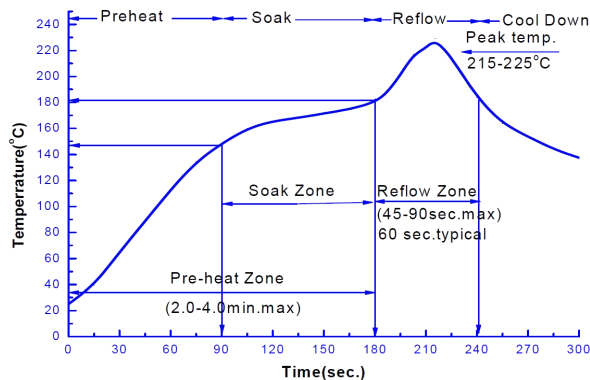
| 接口标识 | 接口说明                |
|------|---------------------|
| ■    | RF IN, RF OUT (可互换) |
| ▨    | GND                 |

**测试曲线:**
**+25℃带内指标典型曲线**


**-55°C 带内指标典型曲线**

**+85°C 带内指标典型曲线**


**带外抑制典型曲线**

**产品使用注意事项:**

1. 产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
2. 产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）；
3. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，推荐采用采用组份 $\geq 2\%$ 的含银焊膏回流焊接，回流温度推荐曲线：



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 230℃。

4. 如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。
7. 其他使用注意事项参考成都宇熙《微波介质陶瓷滤波器产品使用说明》。